

## 实现厚膜点胶的面点胶机 Flat Dispenser [PFD-10]

~ 通过 PFA 原装的扁平喷嘴与电机的点胶量控制，实现均匀稳定的厚膜点胶 ~

株式会社 PFA 为了加入近年备受关注的烧结市场，研究开发了可以点胶烧结材料的面点胶机「PFD-10」。不仅是烧结材料，本设备还可以应用于各种高性能半导体或功率半导体的发热和保护的 TIM (Thermal Interface Material) 点胶。

「PFD-10」使用专用喷嘴调整点胶宽度，喷嘴的内部构造可进行 200 ~ 500 $\mu$ m 的均匀涂布。设备使用位移计在点胶前进行高度测定，因此在有凹凸的基板上也能进行点胶。与传统的印刷机相比，「PFD-10」可进行局部点胶，能节约 20~30% 的材料成本。

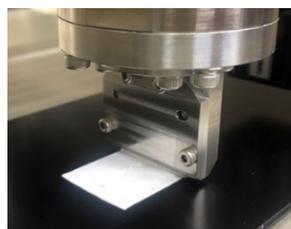
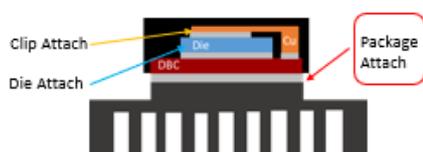


Flat Dispenser [PFD-10]

### 市场背景与产品概要

汽车电源模块的结构是将多个半导体芯片封装于基板并连接到冷却器上，而具有耐热性和散热性的烧结材料 (Sinter) 作为接合材料可以说是现在备受关注的一种材料。

特别是在冷却器和基板的接合工序 (Package Attachment) 过程中，冷却器等会发生翘曲，如果涂膜过薄，接合的牢固性就会下降。因此，为了能够满足厚涂膜点胶的需求，我们开发了可以将烧结材料均匀并以厚涂膜点胶到冷却器上的面点胶机「PFD-10」。



## PFD-10 的主要特征

1. 通过电机自由控制点胶量
2. 采用不受材料粘度变化影响的构造
  - 无脉动，无胶水拉丝拖尾现象，可实现平稳的点胶。
3. 通过位移计修正基板高度的功能
  - 冷却器具有各种不同高度的结构，因此在点胶前测量高度尤为重要，本设备可根据所测量的校正值进行点胶，并可在点胶后测量点胶膜的厚度。
4. 200 ~ 500 $\mu$ m 厚涂膜点胶
  - 可对烧结工序中的 Package Attach 进行厚膜点胶。
5. PFA 原装扁平喷嘴
  - 喷嘴内部的结构实现均匀点胶。此外，涂布宽度可以通过喷嘴宽度调整。
6. 可以生产尺寸 300 $\times$ 300mm 的大型基板或者较重基板

## 基本规格

机种名	面点胶机 Flat Dispenser
型号	PFD-10
设备尺寸	W1002 $\times$ D1256 $\times$ H1600mm (参考)
作业高度	900 $\pm$ 20mm
基板尺寸	300 $\times$ 300mm T=65mm ※其他尺寸欢迎商洽。
点胶喷头	定量机械点胶 ※可以根据涂布形状选择最佳的泵尺寸。
针筒尺寸	30cc、50cc、70cc 每针筒 或 6oz、12oz 每桶
喷嘴宽度	2 ~ 50mm ※2mm 以下、50mm 以上欢迎商洽。
附属功能	基板测高、喷嘴位置校正、空打 喷嘴清洁功能、传送带宽度自动调整
Option	喷嘴回转部、检查功能

※由于性能改良等原因有可能对外观或规格进行变更。

## 设备欢迎咨询下方链接

[联系我们](#) | [Yamaha Robotics Holdings.](#) | [YRH Co., Ltd.](#) | [Yamaha Robotics Holdings.](#) | [YRH Co., Ltd.](#)